

行业及产业

电子

DeepSeek 发布并同步开源 V4 大模型

——电子行业周报 (2026/4/20-4/26)

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势:



资料来源: 聚源数据, 爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业周报: AI 需求持续高景气, 先进制程产能加速扩张》2026-04-20
- 《电子行业周报: Samsung 2026Q1 业绩指引创历史新高》2026-04-13
- 《电子行业周报: AI 算力拉动半导体设备国产替代, 消费电子新兴赛道加速落地》2026-04-07
- 《2026 年电子行业春季策略报告: 兼顾周期与成长, 看好存储芯片景气持续》2026-04-01
- 《电子行业周报: 中芯国际发布 2025 年报收入创历史新高》2026-03-31

投资要点:

- 本周 (2026/4/20-4/26) SW 电子行业指数 (+3.11%), 涨跌幅排名 2/31 位, 沪深 300 指数 (+0.86%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为: 煤炭 (+3.93%), 电子 (+3.11%), 石油石化 (+2.66%), 公用事业 (+2.34%), 食品饮料 (+1.80%), 涨跌幅后五分别为: 农林牧渔 (-3.15%), 综合 (-3.00%), 传媒 (-2.69%), 钢铁 (-2.16%), 社会服务 (-1.73%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是: 被动元件 (+7.48%), 电子化学品 III (+6.61%), 半导体材料 (+5.89%), 涨跌幅后三分别是: 集成电路封测 (-0.87%), LED (-0.81%), 其他电子 III (-0.41%)。
- 本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是: 华特气体 (+94.59%), 光智科技 (+43.68%), 金宏气体 (+32.16%), 泰晶科技 (+31.95%), 富瀚微 (+25.49%)。涨跌幅排名后五的股票分别是: ST 恒久 (-20.96%), 锆威特 (-18.05%), 赛微电子 (-17.71%), 芯动联科 (-16.07%), 久之洋 (-16.01%)。
- **2026 年 4 月 24 日, DeepSeek 正式发布并同步开源 DeepSeek V4 大模型预览版。**该版本以原生 100 万 token 超长上下文为核心突破, 在 Agent 能力、世界知识储备、推理性能三大维度实现跨越式升级, 综合实力稳居开源模型第一梯队。本次发布包含两款差异化定位的 MoE 模型, 其中 DeepSeek-V4-Pro 总参数 1.6 万亿、激活参数 49B, 主打高性能研发, 对标行业顶级闭源大模型; DeepSeek-V4-Flash 总参数 2840 亿、激活参数 13B, 主打轻量化低成本落地, 两款模型均原生搭载 1M 超长上下文能力, 已全面纳入官方标配服务体系。性能层面, V4-Pro 综合表现领跑开源赛道, 智能代理代码评测斩获开源模型最佳成绩, 实测使用体验优于 Sonnet 4.5、代码交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式, 世界知识储备大幅领先同类开源产品, 高难度推理任务性能超越所有公开评测的开源模型, 达到世界级闭源模型水准; V4-Flash 核心推理能力与 Pro 版基本持平, 依托更小的参数量实现更快的 API 响应与更低的部署成本, 仅在超高难度复杂任务上存在性能差距, 可精准适配高性价比产业落地需求。
- **2026 年 4 月 22 日, SK hynix 发布 2026 财年第一季度财报。**报告期内公司实现营业收入 52.58 万亿韩元, 营业利润 37.61 万亿韩元, 净利润 40.35 万亿韩元, 对应营业利润率 72%、净利润率 77%, 在行业传统季节性淡季实现业绩超预期表现。公司管理层表示, 业绩高增核心源于 AI 基础设施投资持续扩大带动存储需求强劲, 公司 HBM、大容量服务器 DRAM、企业级 SSD 等高附加值产品销售放量, 推动业绩延续上行趋势。展望后续, 公司认为存储效率优化技术的普及将提升 AI 服务经济性, 带动服务规模扩容进而拉动存储需求持续增长, 预计 DRAM、NAND 闪存市场均将维持有利的价格环境。产品布局方面, 公司将持续强化 HBM 领域性能、良率、供应稳定性的综合竞争力, DRAM 端将全面推进 1c 工艺 LPDDR6 DRAM 及同工艺 192GB SOCAMM2 产品的量产供应; NAND 端已启动 321 层 QLC 工艺客户端 SSD PQC21 的交付, 同时将完善 eSSD 全领域产品矩阵, 依托子公司 Solidigm 在大容量 QLC eSSD 领域的优势形成协同, 进一步强化 AI 数据中心与 AI PC 存储市场的核心竞争力
- **投资建议:** DeepSeek V4 系列大模型的发布与开源, 实现了开源大模型核心能力的全面跃升, 双产品矩阵精准覆盖高端研发与普惠落地双重需求, 大幅降低 AI 技术落地门槛, 有望加速 AI Agent 规模化商用进程, 为国产大模型生态与算力产业链带来持续增量。建议关注国产大模型产业链的投资机会。
- **风险提示:** 1) AI 大模型技术迭代不及预期风险; 2) 半导体行业周期与供需失衡风险 3) 技术迭代不及预期风险。

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

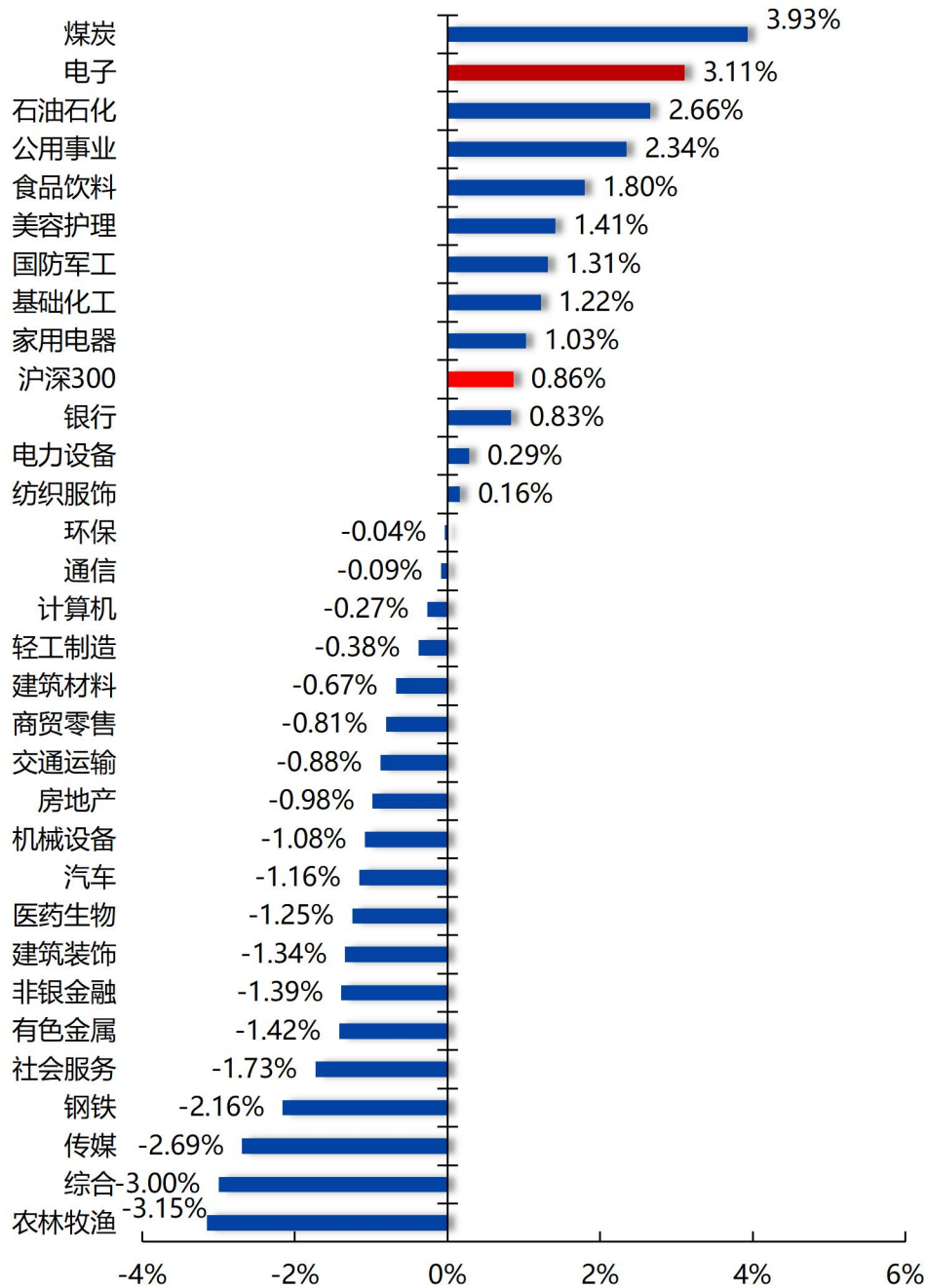
朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数 (+3.11%)，涨跌幅排名 2/31 位，沪深 300 指数 (+0.86%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭 (+3.93%)，电子 (+3.11%)，石油石化 (+2.66%)，公用事业 (+2.34%)，食品饮料 (+1.80%)，涨跌幅后五分别为：农林牧渔 (-3.15%)，综合 (-3.00%)，传媒 (-2.69%)，钢铁 (-2.16%)，社会服务 (-1.73%)。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

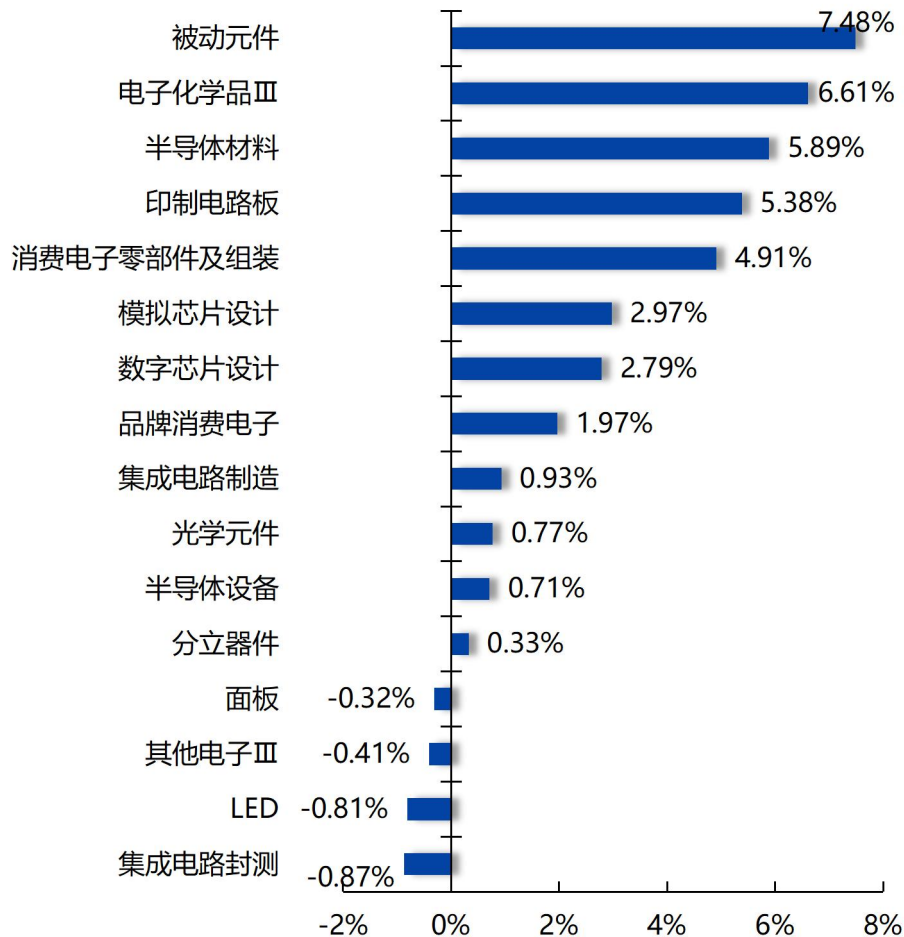


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：被动元件 (+7.48%)，电子化学品Ⅲ (+6.61%)，半导体材料 (+5.89%)，涨跌幅后三分别是：集成电路封测 (-0.87%)，LED (-0.81%)，其他电子Ⅲ (-0.41%)。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



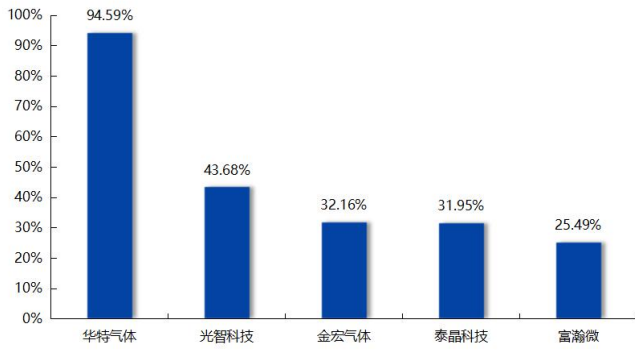
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：华特气体 (+94.59%)，光智科技 (+43.68%)，金宏气体 (+32.16%)，泰晶科技 (+31.95%)，富瀚微 (+25.49%)。

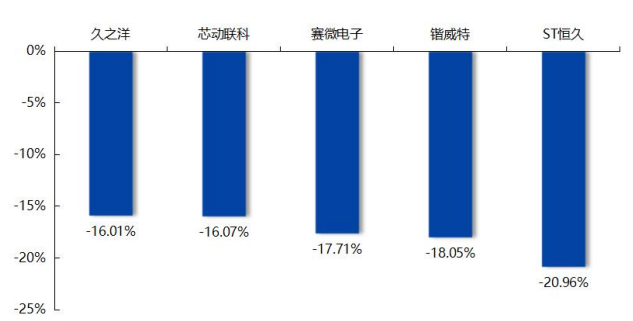
涨跌幅排名后五的股票分别是：ST 恒久 (-20.96%)，锆威特 (-18.05%)，赛微电子 (-17.71%)，芯动联科 (-16.07%)，久之洋 (-16.01%)。

图表 3: SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 4: SW 电子个股本周涨跌幅后五

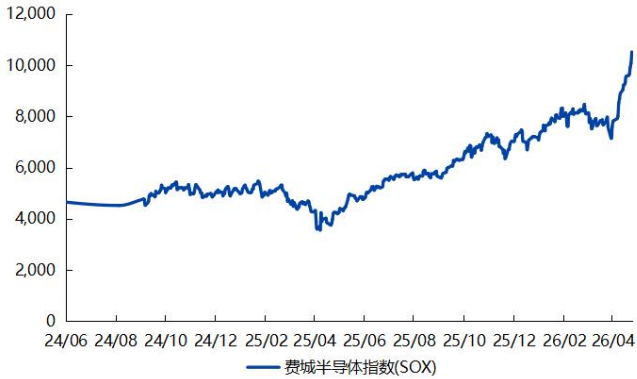


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+10.02%, 恒生科技指数本周涨跌幅为-2.79%。

图表 5: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

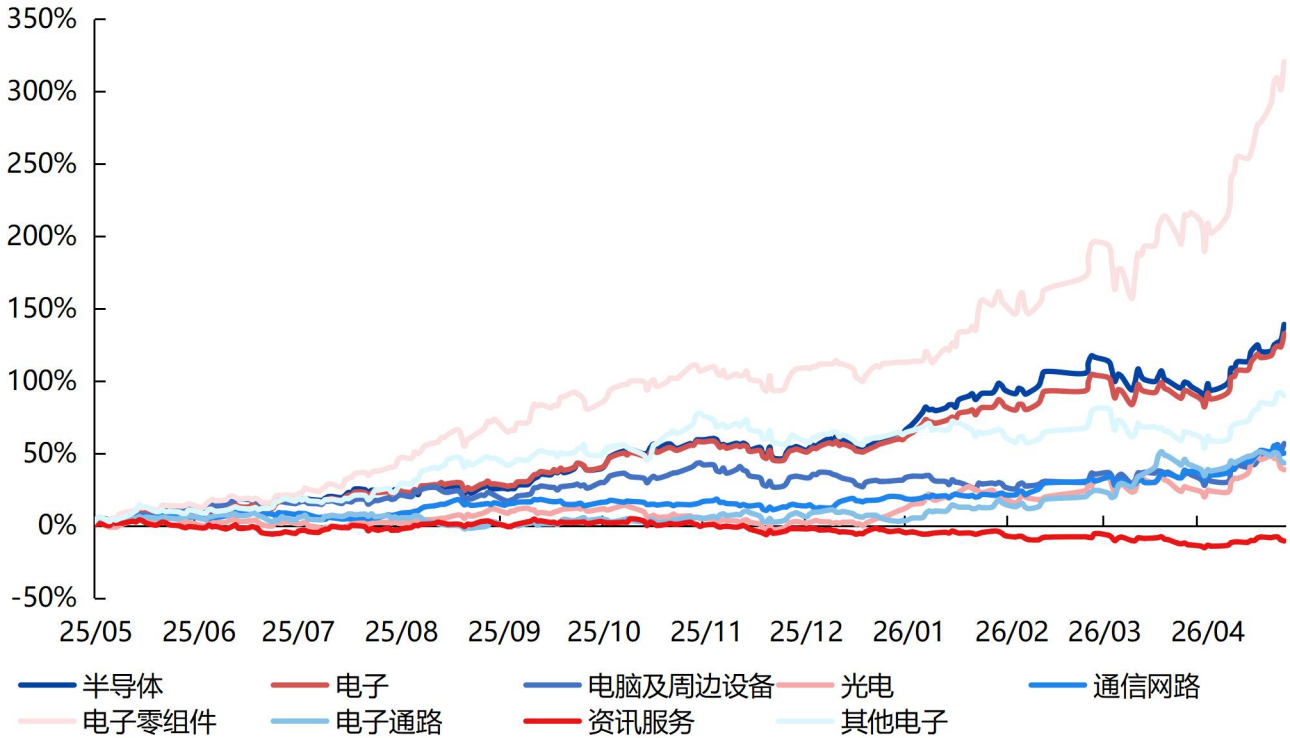
图表 6: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块上周涨跌幅分别为: 半导体 (+8.47%)、电子 (+7.62%)、电脑及周边设备 (+6.75%)、光电 (-4.86%)、通信网路 (-1.24%)、电子零组件 (+10.97%)、电子通路 (-5.08%)、资讯服务 (-2.97%)、其他电子 (+2.63%)。

图表 7: 2025 年 5 月-2026 年 4 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 Deepseek V4 正式发布

2026年4月24日, DeepSeek 发布全新大模型 DeepSeek V4 预览版, 并同步开源。本次 V4 版本最大的核心在于 1M 超长上下文, 并在 Agent 能力、世界知识和推理性能上实现了对开源领域的全新领先。

本次发布的 DeepSeek V4 包含两款混合专家 (MoE) 模型, 分别适配不同场景需求。其中 DeepSeek-V4-Pro 主打高性能研发, 总参数 1.6 万亿、激活参数 49B, 聚焦尖端复杂任务, 整体性能对标行业顶级闭源大模型; DeepSeek-V4-Flash 主打轻量化、低成本落地, 总参数 2840 亿、激活参数 13B, 主打高性价比部署。两款模型均原生搭载 1M 超长上下文能力, 全面纳入 DeepSeek 官方标配服务体系。

性能层面, DeepSeek-V4-Pro 综合表现领跑开源赛道。在智能代理代码评测 (Agentic Coding) 中斩获开源模型最佳成绩, 目前已投入企业内部落地使用, 实际使用体验优于 Sonnet 4.5, 代码交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。在世界知识测评中, 模型大幅领先同类开源产品, 仅略次于顶级闭源模型 Gemini-Pro-3.1。同时, 该模型在数学运算、STEM 专业问题、竞赛级代码编写等高难度推理任务中, 性能超越所有公开评测的开源模型, 达到世界级闭源模型水准。

对比来看, DeepSeek-V4-Flash 知识储备略弱于 Pro 版本, 但核心推理能力基本持平。依托更小的参数量与激活体量, Flash 版 API 服务响应更快、部署成本更低, 商业化落地优势显著。在基础智能代理任务中, Flash 版性能与 Pro 版旗鼓相当, 仅在

超高难度复杂任务中存在一定性能差距，能够精准适配轻量化、高性价比的产业落地需求。

2.2 SK hynix 发布 2026 财年第一季度财报

2026 年 4 月 22 日，SK hynix 发布了 2026 财年第一季度财报。财报数据显示，公司 2026 财年第一季度营业收入为 52.5763 万亿韩元，营业利润为 37.61 万亿韩元，净利润为 40.35 万亿韩元。2026 财年第一季度营业利润率为 72%，净利润率为 77%。

SK hynix 管理层表示：“尽管第一季度通常是季节性淡季，但在人工智能（AI）基础设施投资扩大的推动下，市场需求持续强劲。公司通过扩大高带宽存储器（HBM）、大容量服务器 DRAM 模块、企业级固态硬盘（eSSD）等高附加值产品的销售，延续了业绩上升势头。”

SK hynix 预测，存储效率优化技术的普及将提高人工智能服务的经济性，进而推动整体服务规模的扩大，进一步拉动存储器需求。基于此，公司预计 DRAM 和 NAND 闪存市场均将维持有利的价格环境。

在 HBM 领域，公司将进一步加强整合性能、良率、质量及供应稳定性的综合执行能力；在 DRAM 领域，公司将全面启动全球首款采用第六代 10 纳米级（1c）工艺的 LPDDR6 DRAM，以及基于同一工艺、于本月开始量产的 192GB SOCAMM2 的供应。

在 NAND 闪存方面，公司在开始供应基于 CTF 技术、采用 321 层 QLC 工艺的客户端固态硬盘（cSSD）“PQC21”的同时，将通过在 eSSD 全领域构建涵盖高性能 TLC 和大容量 QLC 的产品阵容，灵活应对人工智能领域的整体需求。此外，公司将依托在大容量 QLC eSSD 领域具备优势的 Solidigm 形成的协同效应，进一步加强在 AI 数据中心和 AI PC 存储器市场的竞争力。

2.3 Google 举办 2026 Next 大会

美国时间 2026 年 4 月 22 日，Google 举办 2026 Next 大会，发布了旨在推动企业工作流程全面转向智能体的“代理式企业”（Agentic Enterprise）技术栈，涵盖第八代 TPU、智能体软件平台等一系列前沿创新。

发布会伊始，Google CEO 皮查伊在一段预录的视频中重申了资本开支的巨额增长，称今年将投入 1750 亿-1850 亿美元，较 2022 年的 310 亿美元翻了近 6 倍。

基于 Vertex AI 平台底座，Google Cloud 本次全新推出 Gemini Enterprise 代理平台。该平台是专为 AI 代理的搭建、扩展、治理与优化打造的全流程解决方案，在整合原有模型选择、模型开发、AI 代理构建能力的基础上，新增了代理整合、开发运维、任务调度与安全管控等核心功能。

本次大会最受资本市场关注的第八代张量处理单元（TPU）正式亮相，Google 首次将新一代 TPU 拆分为两款专用芯片，分别适配 AI 训练与推理两大核心场景。

其中，面向 AI 模型训练的 TPU 8t，阵列计算性能较上一代 Ironwood 提升近 3 倍，每瓦性能最高提升至两倍，全面强化大模型训练端的算力支撑能力。专为推理任务打造的 TPU 8i，是 Google 破解行业“内存墙”痛点的核心产品。为解决处理器空闲等待问题，TPU 8i 配备 288GB 高带宽内存（HBM）与 384MB 片上 SRAM，其中片上 SRAM 容量达到上一代的 3 倍，可实现模型活跃工作集完全在芯片内部运行，大幅提升推理效率。

2.4 Intel 发布 2026 财年第一季度财报

2026 年 4 月 24 日，Intel 发布 2026 财年第一季度财报。报告显示，公司 Q1 营收达 136 亿美元，连续第六个季度超预期，同比增长 7%；净利润同比大涨 156%，盈利能力显著改善。

分业务来看，数据中心与 AI 业务收入同比飙升 22%，AI 需求推动 CPU 重回核心地位。代工业务表现亮眼，Q1 营收大涨 16%，Intel 18A 工艺落地，先进封装需求激增，Intel 14A 已获特斯拉采用。客户端业务营收 77 亿美元，第三代酷睿 Ultra 驱动 PC 业务强劲复苏。

2.5 SK hynix 斥资 19 万韩元新建 AI 存储先进封装基地

2026 年 4 月 22 日，SK hynix 在清州举行 P&T7 厂区动工仪式。该项目总投资规模达 19 万亿韩元，将分阶段建设，晶圆测试（WT）产线计划于 2027 年 10 月投产，晶圆级封装（WLP）产线则于 2028 年 2 月投用。

SK hynix 表示，P&T7 是专门面向 HBM 等 AI 存储产品打造的先进封装基地，该厂区也将成为继 M11、M12、M15 及 M15X h 之后，公司在清州布局的第五座生产基地。新厂区将与周边现有产线形成显著协同效应，进一步巩固清州作为全球先进存储核心生产枢纽的地位。

值得关注的是，除韩国本土布局外，SK hynix 正持续加码 HBM 先进封装的全球化布局。据《韩国经济新闻》消息，在 2024 年公布投资计划约两年后，公司在美国印第安纳州的首座半导体工厂已正式动工，该厂区计划 2028H2 全面量产，主力产品为 HBM4E、HBM5 等下一代高带宽存储芯片。

3. 风险提示

1) AI 大模型技术迭代不及预期风险：以 DeepSeek V4 为代表的开源大模型虽实现核心能力跨越式突破，但 AI 大模型技术仍处于高速迭代阶段，若后续模型技术升级、

开源生态建设不及预期，或行业同质化竞争加剧引发 API 价格战、私有化部署毛利率下滑，将直接影响相关企业的盈利兑现与行业成长空间。

2) 半导体行业周期与供需失衡风险：存储芯片行业具备强周期属性，若厂商产能扩张过快、下游 AI 需求增速不及预期，将引发产品价格大幅波动，企业盈利承压。

3) 技术迭代不及预期风险：HBM 先进封装、先进制程工艺、AI 算力芯片的研发突破、产能爬坡与量产落地存在不及预期的风险，将影响相关企业的市场份额与业绩释放节奏。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归属爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。